

低压等离子清洁/去光阻设备 PC03/PC04/PA03B

各式基材在印刷或黏著前之表面活化、改质、接枝、粗糙化或清洁等

特点

- 处理均匀性佳
- 离子能量低、不损伤基板
- 没有电极及基板的污染
- 专利设计之特殊等离子电极
- 高密度等离子源
 - 等离子效率高、清洁效率高
 - 可控制低的离子能量
 - 结合化学反应性及物理撞击性
- 处理速度快、清洁效率高、可靠度高
- 操作范围广
- 可使用多种制程气体
- 全自动且容易操作
- 设备稳定高，容易维护
- 可依客户需求作更改



项目	PC03 / PC04	PA03B
Applications	<ul style="list-style-type: none"> ■ LCM、IC 封装 (Flip Chip , CSP , BGA , Lead Frame , etc.)、LED 封装、SMT、PCB、FPC、光电元件、电子元件、封装贴合前清洁 ■ 印刷或黏著前之表面粗化或清洁 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 残余光阻去除 ■ 蓝膜残胶去除 ■ PSS 来料清洁制程
Footprint	1270(W)×1100(D)×2216(H)mm	
Chamber Size	500(W)×500(D)×500(H)mm	
Weight	880kg	
Facilities	3Ø220V×60Hz×4w , 30A Compressed air : ~6 kg/cm ² Reaction gas : ~3 kg/ cm ²	3Ø220V×60Hz×4w , 50A Compressed air : ~6 kg/cm ² Reaction gas : ~3 kg/ cm ²
System Control Software	PC or PLC	
Gas Flow System	2 mass flow controllers	1 mass flow controllers
Vacuum Pump	Rotary (80m ³ /hr) + Roots(250m ³ /hr)	Rotary pump
Reactants	O ₂ , Ar, H ₂ , N ₂ & mixing gases	O ₂ ,N ₂ ,H ₂ ,CF ₄ ,&mixing gases

